

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年8月6日(06.08.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/157805 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 163/00 (2006.01) C09J 133/02 (2006.01)
C09J 7/35 (2018.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/50 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/002789

(22) 国際出願日: 2019年1月28日(28.01.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 日立化成株式会社(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 橋本 慎太郎(HASHIMOTO Shintaro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 矢羽田 達也(YAHATA Tatsuya); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 舩野 大輔(MASUNO Daisuke); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 谷口 紘平(TANIGUCHI Kouhei); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 中村 祐樹(NAKAMURA Yuki); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, FILM-LIKE ADHESIVE, ADHESIVE SHEET AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、フィルム状接着剤、接着シート、及び半導体装置の製造方法

(57) Abstract: The present invention discloses an adhesive composition which contains a thermosetting resin, a curing agent and an elastomer, and which is configured such that: the thermosetting resin contains an epoxy resin that has an alicyclic ring; and the elastomer contains an elastomer that has a carboxy group. The present invention also discloses a film-like adhesive which uses this adhesive composition. The present invention additionally discloses: an adhesive sheet which uses this film-like adhesive; and a method for producing a semiconductor device.

(57) 要約: 熱硬化性樹脂と硬化剤とエラストマーとを含有し、熱硬化性樹脂が脂環式環を有するエポキシ樹脂を含み、エラストマーがカルボキシ基を有するエラストマーを含む接着剤組成物が開示される。また、このような接着剤組成物を用いたフィルム状接着剤が開示される。さらに、このようなフィルム状接着剤を用いた接着シート及び半導体装置の製造方法が開示される。



WO 2020/157805 A1